

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公司2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价为48.47元/股，募集资金总额为人民币48,470万元，根据有关规定扣除发行费用人民币4,351.60万元（不含税）后，实际募集资金金额为44,118.40万元。该募集资金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月20日出具天职业字[2020]32804号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集资金项目41,892.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,225.55万元，募集资金专用账户利息收入962.54万元，募集资金专户2023年12月31日结余合计为3,188.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司董事会批准开设了中国建设银行合肥青年路支行（以下简称“青年路支行”）34050145470800001828、中国银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“北碚支行”）

111674531230、北碚支行 113074526840 三个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2021年1月14日，公司、公司之子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）与青年路支行和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在青年路支行开设募集资金专项账户（账号：34050145470800001828）。

2021年4月13日，公司、公司之子公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称“重庆翰博显示”）、重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称“重庆翰博显示研发中心”）分别与北碚支行和中信建投证券签署《募集资金四方监管协议》，在北碚支行开设募集资金专项账户（账号：111674531230、113074526840）。

2023年5月9日，公司、公司之子公司博讯光电与青年路支行和华泰联合证券重新签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司之子公司重庆翰博显示、重庆翰博显示研发中心分别与北碚支行和华泰联合证券重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专户均未发生变化。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行合肥青年路支行	34050145470800001828	2,581.52
中国银行股份有限公司重庆水土支行	111674531230	606.23
中国银行股份有限公司重庆水土支行	113074526840	0.34
合计		3,188.09

注：中国银行股份有限公司重庆水土支行为北碚支行的二级支行

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 41,892.85 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专用账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

前期变更募集资金投资项目的情况如下：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更募集资金用途

公告》及相关公告：公司决定将原募集资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”暂未使用的募集资金 14,092.04 万元（其中本金 14,000.00 万元，利息 92.04 万元）用于本次新增募投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 25 日，华泰联合证券针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。专项核查报告认为，翰博高新严格执行募集资金专户存储制度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对翰博高新在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,118.40				本年度投入募集资金总额	7,808.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	41,892.85			
累计变更用途的募集资金总额		14,092.04								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.94%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	是	8,000.00	8,000.00	2,757.01	7,503.67	93.80	2024-9-30	不适用	不适用	无
2、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	是	6,092.04	6,092.04	1,367.33	6,287.99	103.22	2024-9-30	不适用	不适用	无
3、背光源智能制造及相关配套设施建设项目	否	14,192.40	14,192.40	3,684.38	12,147.63	85.59	2024-9-30	不适用	不适用	无
4、补充流动资金	否	15,926.00	15,926.00	-	15,953.56	100.17	不适用	不适用	不适用	无
承诺投资项目小计		44,210.44	44,210.44	7,808.72	41,892.85					
合计		44,210.44	44,210.44	7,808.72	41,892.85					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》：在募投项目实施主体、实施方式、资金用途和投资总额均不发生变化的情况下，将“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”、“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，公司变更募集资金使用方式，将募集资金 14,192.4 万元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	银行存款账户结余
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

2023 年变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	有机发光半导体(OLED)制造装置零部件	8,000.00	2,757.01	7,503.67	93.80	2024-9-30	不适用	不适用	否
重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	剥离、精密再生及热喷涂(二期)	6,092.04	1,367.33	6,287.99	103.22	2024-9-30	不适用	不适用	否
合计	-	14,092.04	4,124.34	13,791.66	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					为应对日益变化的市场环境,公司将用新项目扩大公司产能,延伸产业链条,提升公司科研实力,增强公司经营能力和竞争力。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注:公司于2021年3月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:截至2021年2月28日,本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂(二期)项目暂未使用的募集资金14,092.04万元(其中本金14,000.00万元利息92.04万元)。变更的资金拟用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。